

(上接13版) 本次发行价格65.99元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为36.38倍,低于中证指数有限公司2026年7月27日(T-4日)发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率70.62倍,低于同行业可比上市公司2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率78.79倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。 本次发行定价合理性说明如下: ①半导体设备及零部件行业景气度持续上行,国产替代空间广阔,公司作为本土头部企业将持续受益 我国半导体设备及零部件市场正处于下游需求旺盛增长与国产替代加速推进的双重驱动期。在全球AI算力需求爆发、先进制程持续迭代、国内晶圆厂大规模扩产的背景下,半导体设备资本开支保持高位运行,直接拉动对设备零部件尤其是特殊涂层零部件的需求。根据弗若斯特沙利文的研究报告,2024年中国大陆半导体设备特殊涂层零部件市场持续扩容,但整体国产化率仍处于较低水平,仅为7.1%,预计至2029年将提升至约12.4%,本土企业成长空间巨大。从半导体设备整体来看,根据华泰证券研究所数据,2025年国内半导体设备国产化率预计为23%,2026年预计进一步提升至29%,国产设备厂商的加速崛起为本土零部件供应商打开了明确的配套窗口。 在此趋势下,具备先进制程零部件供应能力的头部企业将获得更大的成长弹性——根据弗若斯特沙利文报告,发行人2024年在半导体设备特殊涂层零部件本土企业中的市场份额排名第一,在中国大陆市场整体份额为5.7%。 2023至2025年,发行人营业收入分别为16,905.00万元、25,687.80万元和49,573.87万元,年均复合增长率达71.25%,归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为6,642.45万元、8,551.46万元和20,368.21万元,年均复合增长率达75.11%,经营业绩随行业景气上行和国产替代提速实现高速增长。随着AI算力驱动先进制程产能持续扩张,中芯国际14nm/7nm及更先进产线、长江存储及长鑫存储等先进存储产线迭代升级,对特殊涂层零部件的需求将保持旺盛态势,发行人的成长具备坚实的行业基本面支撑。 ②公司聚焦特殊涂层核心技术自主研发,构建了“三位一体”的高壁垒技术护城河 发行人自2005年成立以来,始终以自主研发为核心驱动力,深耕特殊涂层工艺及其关联技术和材料领域,构建了覆盖半导体设备特殊涂层零部件的完整技术体系。发行人系国家级专精特新重点“小巨人”企业、国家重点研发计划课题承担单位及四川省企业技术中心,依托长期技术积累,形成了特殊涂层工艺及其关联技术、特殊涂层材料及陶瓷材料制备技术、生产装备自主化研制技术三大核心技术矩阵,三者高度协同、相互依存,单独掌握其中一项或两项均难以满足先进制程半导体设备需求,构成“三位一体”的高壁垒技术护城河。 在特殊涂层工艺端,发行人掌握稳定量产的高难度物理气相沉积(PVD)工艺及高致密等离子喷涂(HDPS)工艺,其中PVD工艺难度极高,属国内极少数掌握的涂层技术——除发行人外,国内半导体零部件厂商尚未掌握稳定量产的PVD工艺;海外厂商如日本TOCALO出于保密需求与政策限制,即使在中国大陆建立工厂也未引入PVD工艺,仅在其本土生产。与KoMiCo等海外竞争对手官网公开的技术指标对比,发行人特殊涂层的孔隙率不亚于国外领先竞争对手,膜厚、结合强度等关键指标具有竞争优势。在先进制程应用端,发行人	
(上接13版) 略合作关系。发行人于2011年进入客户B供应链体系、2016年进入客户A供应链体系,合作至今均逾十年,曾荣获客户B颁发的“卓越合作伙伴暨杰出表现奖”“杰出支持奖”以及客户A颁发的“协同创新奖”“全球战略合作商奖”,合作关系深厚且稳固。 半导体设备零部件行业存在极高的客户认证壁垒。零部件从送样验证到量产导入,通常需要一年以上的完整认证周期,特殊涂层零部件因直接参与晶圆制造的工艺反应、对芯片良率影响重大,认证要求更为严格——每次上线测试需晶圆厂安排停机配合,单次验证成本高昂,且产能宝贵的晶圆厂通常不会向新供应商开放多次测试机会。设备厂商选取零部件供应商时亦极为审慎,出于对整机性能与交付周期的保障,往往优先选择已有长期合作基础的成熟供应商。发行人在这一高壁垒领域已建立起显著的先发优势和产业生态位,与下游客户形成了“零部件—设备—晶圆厂”三方联动的创新闭环:通过提前参与设备厂商下一代产品研发获取前瞻性技术需求,同时接收晶圆厂终端使用反馈持续迭代涂层方案,大幅提升了客户黏性与替代成本。 在核心客户深度之外,发行人也持续推进客户结构多元化。报告期内,在客户A、客户B两大基石客户基础上,已成功拓展客户C、客户D、客户E、客户F、鲁汶仪器等多家知名半导体客户。其中与客户D在光刻、量检测等尖端设备领域开展了深度合作,报告期各期对除客户A、客户B外其他半导体客户的销售收入金额分别为3,334.15万元、5,401.76万元和15,201.27万元,呈现快速增长态势,客户多元化情况持续提升。 ④公司产品品类持续延伸,从刻蚀零部件龙头向多品类平台型供应商稳步演进 发行人充分利用特殊涂层工艺的通用性和技术积累的可延展性,持续丰富产品种类,已从刻蚀设备零部件向光刻、量检测、薄膜沉积、退火、离子注入、外延等多类型半导体前道制造设备零部件持续延伸,向综合性的平台型半导体核心零部件供应商稳步推进。 刻蚀设备零部件是报告期内发行人收入和利润的主要来源,但发行人向客户A供应刻蚀设备零部件的同时,已成功拓展供应薄膜沉积、退火、离子注入等非刻蚀设备零部件,向客户B供应外延设备零部件。在光刻及量检测领域,发行人实现了光学类特殊涂层零部件的国产化突破——自2020年起与客户C建立合作,后续与客户D深度合作,针对光刻机研发需求,提供透镜、反射镜等光学类特殊涂层零部件,当前已参与到客户牵头的极紫外光刻子系统零部件的配套研发。报告期内,发行人应用于光刻及量检测设备的反射镜、光学窗口等产品收入实现从无到有的突破,报告期各期收入分别为220.93万元、788.75万元和2,886.00万元;非刻蚀(光刻、量检测、退火等)设备零部件销售收入从879.55万元增长至4,668.88万元,年均复合增长率达130.40%。 (2)本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为309家,管理的配售对象个数为11,063个,约占剔除无效报价后所有配售对象总数的96.03%;对应的有效拟申购数量总和为5,758,440万股,约占剔除无效报价后拟申购总量的96.55%,为战略配售回拨后,网上网下回拨前网下初始发行规模的4,421.78倍。 (3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之	
开发的介质窗、喷淋头等刻蚀设备核心零部件已通过5nm及以下制程工艺验证,成为国内极少数实现量产的企业,技术指标达到国际和国内先进制程晶圆厂要求,并成功导入多家国产半导体设备龙头供应链体系;重要客户客户B的等离子体刻蚀设备已应用于国际一线客户的5纳米、3纳米及更先进一代集成电路加工制造生产线。由客户A、客户B、鲁汶仪器等头部客户出具的技术及应用证明表明,发行人的特殊涂层零部件产品在国际领先的先进制程刻蚀设备上大规模应用,等离子体耐受性、温度冲击性、超低颗粒污染等关键性能取得突破,孔隙率、表面粗糙度、硬度、膜层厚度等关键技术参数达到国际领先水平。 在研发人才与创新机制方面,发行人截至报告期末拥有研发人员43人,占员工总数的12.08%,核心技术人员柴杰、柴林长期深耕特殊涂层领域,研发方向持续稳定。发行人与四川大学、北京航空航天大学共同承担国家重点研发计划“高性能制造技术与重大装备”专项课题“透明陶瓷制造技术及装备”。此外,发行人对未以专利形式公开的大量核心工艺参数、配方、材料改性方法以专有技术实施严密保护,建立了权限分级、物理隔离、分段管理、协议约束等系统化保密体系,确保技术成果不外溢。在半导体零部件领域严苛的认证体系和发行人持续迭代的技术壁垒双重保护下,竞争者短期内突破和替代发行人的可能性较低。 ③公司与下游头部客户深度绑定十余年,客户认证壁垒和产业生态协同形成长期护城河 发行人与国内头部半导体设备厂商建立了高度稳定的战略合作关系。发行人于2011年进入客户B供应链体系、2016年进入客户A供应链体系,合作至今均逾十年,曾荣获客户B颁发的“卓越合作伙伴暨杰出表现奖”“杰出支持奖”以及客户A颁发的“协同创新奖”“全球战略合作商奖”,合作关系深厚且稳固。 半导体设备零部件行业存在极高的客户认证壁垒。零部件从送样验证到量产导入,通常需要一年以上的完整认证周期,特殊涂层零部件因直接参与晶圆制造的工艺反应、对芯片良率影响重大,认证要求更为严格——每次上线测试需晶圆厂安排停机配合,单次验证成本高昂,且产能宝贵的晶圆厂通常不会向新供应商开放多次测试机会。设备厂商选取零部件供应商时亦极为审慎,出于对整机性能与交付周期的保障,往往优先选择已有长期合作基础的成熟供应商。发行人在这一高壁垒领域已建立起显著的先发优势和产业生态位,与下游客户形成了“零部件—设备—晶圆厂”三方联动的创新闭环:通过提前参与设备厂商下一代产品研发获取前瞻性技术需求,同时接收晶圆厂终端使用反馈持续迭代涂层方案,大幅提升了客户黏性与替代成本。 在核心客户深度之外,发行人也持续推进客户结构多元化。报告期内,在客户A、客户B两大基石客户基础上,已成功拓展客户C、客户D、客户E、客户F、鲁汶仪器等多家知名半导体客户。其中与客户D在光刻、量检测等尖端设备领域开展了深度合作,报告期各期对除客户A、客户B外其他半导体客户的销售收入金额分别为3,334.15万元、5,401.76万元和15,201.27万元,呈现快速增长态势,客户多元化情况持续提升。 ④公司产品品类持续延伸,从刻蚀零部件龙头向多品类平台型供应商稳步演进 发行人充分利用特殊涂层工艺的通用性和技术积累的可延展性,持续丰富产品种类,已从刻蚀设备零部件向光刻、量检测、薄膜沉积、退火、离子注入、外延等多类型半导体前道制造设备零部件持续延伸,向综合性的平台型半导体核心零部件供应商稳步推进。 刻蚀设备零部件是报告期内发行人收入和利润的主要来	
源,但发行人向客户A供应刻蚀设备零部件的同时,已成功拓展供应薄膜沉积、退火、离子注入等非刻蚀设备零部件,向客户B供应外延设备零部件。在光刻及量检测领域,发行人实现了光学类特殊涂层零部件的国产化突破——自2020年起与客户C建立合作,后续与客户D深度合作,针对光刻机研发需求,提供透镜、反射镜等光学类特殊涂层零部件,当前已参与到客户牵头的极紫外光刻子系统零部件的配套研发。报告期内,发行人应用于光刻及量检测设备的反射镜、光学窗口等产品收入实现从无到有的突破,报告期各期收入分别为220.93万元、788.75万元和2,886.00万元;非刻蚀(光刻、量检测、退火等)设备零部件销售收入从879.55万元增长至4,668.88万元,年均复合增长率达130.40%。 (2)本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为309家,管理的配售对象个数为11,063个,约占剔除无效报价后所有配售对象总数的96.03%;对应的有效拟申购数量总和为5,758,440万股,约占剔除无效报价后拟申购总量的96.55%,为战略配售回拨后,网上网下回拨前网下初始发行规模的4,421.78倍。 (3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之	
源,但发行人向客户A供应刻蚀设备零部件的同时,已成功拓展供应薄膜沉积、退火、离子注入等非刻蚀设备零部件,向客户B供应外延设备零部件。在光刻及量检测领域,发行人实现了光学类特殊涂层零部件的国产化突破——自2020年起与客户C建立合作,后续与客户D深度合作,针对光刻机研发需求,提供透镜、反射镜等光学类特殊涂层零部件,当前已参与到客户牵头的极紫外光刻子系统零部件的配套研发。报告期内,发行人应用于光刻及量检测设备的反射镜、光学窗口等产品收入实现从无到有的突破,报告期各期收入分别为220.93万元、788.75万元和2,886.00万元;非刻蚀(光刻、量检测、退火等)设备零部件销售收入从879.55万元增长至4,668.88万元,年均复合增长率达130.40%。 (2)本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为309家,管理的配售对象个数为11,063个,约占剔除无效报价后所有配售对象总数的96.03%;对应的有效拟申购数量总和为5,758,440万股,约占剔除无效报价后拟申购总量的96.55%,为战略配售回拨后,网上网下回拨前网下初始发行规模的4,421.78倍。 (3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之	
(2)本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为309家,管理的配售对象个数为11,063个,约占剔除无效报价后所有配售对象总数的96.03%;对应的有效拟申购数量总和为5,758,440万股,约占剔除无效报价后拟申购总量的96.55%,为战略配售回拨后,网上网下回拨前网下初始发行规模的4,421.78倍。 (3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之	
(4)《成都超纯应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的募集资金需求金额为112,468.00万元,本次发行价格65.99元/股对应融资规模为168,020.70万元,扣除发行费用约12,301.56万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为155,719.14万元(如存在尾数差异,为四舍五入造成),高于前述募集资金需求金额。 (5)本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何疑问,建议不参与本次发行。 (6)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。 2、根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,本次公开发行新股2,546.1539万股,本次发行不设老股转让。按本次发行价格65.99元/股计算,预计募集资金总额为168,020.70万元,扣除发行费用约12,301.56万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为155,719.14万元,如存在尾数差异,为四舍五入造成。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行	
与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。 9、网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。 10、网下投资者应根据《成都超纯应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2026年8月4日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。 认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象当日获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按照规定填写备注。 网上投资者申购新股中签后,应根据《成都超纯应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2026年8月4日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下、网上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。 11、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 12、网下投资者应当结合行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额,不得超资产规模申购。提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将该违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 13、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。 14、网下、网上申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制,对网下、网上的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》中“一、(六)回拨机制”。 15、本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上	
市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。 16、本次发行前的股份有限限售,有关限售承诺及限售期安排详见《招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。 17、中国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。 18、请投资者务必关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施: (1)网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量的; (2)若网上申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购的; (3)网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%; (4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; (5)根据《证券发行与承销管理办法》和《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》,中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形,发行人和主承销商将中止发行并及时公告中止发行原因、后续安排等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行人、主承销商、深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将尽快安排已缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和主承销商将择机重启发行。 19、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2026年7月23日(T-6日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址www.chinadaily.com.cn;中网网,网址www.cs.com.cn;证券日报网,网址www.zqrb.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com)上的《招股意向书》全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 20、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。	
发行人:成都超纯应用材料股份有限公司 保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 2026年7月30日	